

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：

杭州长川科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长川科技	股票代码	300604
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵游		
办公地址	杭州市滨江区聚才路 410 号		
传真	0571-88830180		
电话	0571-85096193		
电子信箱	zhaoyou@hzcctech.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事集成电路专用测试设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。报告期内，公司收购新加坡半导体自动化设备制造企业 Semiconductor Technologies & Instruments Pte Ltd.（以下简称“STI”），STI 的主要产品是自动化半导体光学检测设备（AOI），致力于为全球半导体封测代工厂（OSAT）和具备封测能力的集成器件制造商（IDM）提供光学检测解决方案，与公司主营业务类似。

公司目前主要产品及其用途：

公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备、自动化半导体光学检测设备等，目前本公司主要销售产品为测试机、分选机及自动化生产线，自主设计研发探针台。公司生产的测试机包括大功率测试机、模拟/数模混合测试等；分选机包括重力式分选机、平移式分选机、测编一体机；自动化半导体光学检测设备包括Hexa EVO系列、晶圆光学检测iFocus系列、Sort系列；自动化设备包括指纹模组系列、摄像头模组系列。

纵观2019年，由于受到全球贸易摩擦、经济滞缓等因素的影响，全球半导体产业退滑的迹象十分明显，一些半导体产业巨头对设备投入较为谨慎。SEMI估计全球半导体设备销售额2019年下降到596亿美元左右，较2018年下降7.6%。其中主要减少在对DRAM和NAND存储器的投资上，其中韩国有可能较2018年减少22.9%，是近三年来设备投资首次大幅度下滑。除了韩国之外，中国大陆、亚太地区、欧洲地区预计都有不同程度的下滑，但中国台湾、日本、北美都将有所增长。

报告期内，受到半导体行业周期波动影响，公司及时调整研发及销售策略，主营业务收入增速放缓，净利润受研发投入大幅增大、固定资产折旧、限制性股票股份支付费用影响，较同期相比有所下将。报告期内，公司实现营业收入39,883.41万元，同比增长84.54%；归属于上市公司股东的净利润1,193.53万元，同比下降67.27%。

报告期内，公司的经营模式未发生变化，公司所属行业的发展阶段、行业整体发展情况、行业政策、周期性特点、公司所处行业的地位、所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况、产品核心技术以及成本控制等因素等，请详见《第三节公司业务概要之三、核心竞争力分析》、《第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析》、《第四节经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望》。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	398,834,098.54	216,121,510.66	84.54%	179,794,483.54
归属于上市公司股东的净利润	11,935,305.79	36,471,059.63	-67.27%	50,252,869.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,866,036.62	27,956,496.42	-163.91%	35,922,752.31
经营活动产生的现金流量净额	-42,889,765.25	12,449,428.95	-444.51%	14,712,991.02
基本每股收益（元/股）	0.04	0.13	-69.23%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.13	-69.23%	0.20
加权平均净资产收益率	1.71%	8.21%	-6.50%	14.66%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,321,218,368.95	678,387,815.05	94.76%	539,505,026.47
归属于上市公司股东的净资产	996,569,677.42	470,561,114.97	111.78%	419,280,509.08

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,752,193.98	59,340,727.35	100,342,410.29	196,398,766.92
归属于上市公司股东的净利润	482,029.70	594,020.79	244,502.70	10,614,752.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,775,284.25	-6,170,413.23	-4,070,421.81	-2,849,917.33
经营活动产生的现金流量净额	-5,629,148.74	-16,721,244.66	-41,087,312.22	20,547,940.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

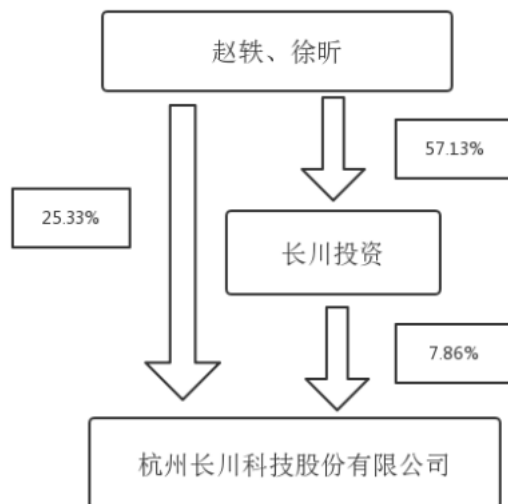
报告期末普通股股东总数	21,239	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
赵轶	境内自然人	25.33%	79,606,419	79,606,419	质押	35,199,066	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.85%	30,960,411	10,327,620			
杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.86%	24,709,544	24,709,544			
钟锋浩	境内自然人	6.39%	20,091,057	20,091,057	质押	5,415,241	
孙峰	境内自然人	3.36%	10,560,551	10,560,551	质押	6,065,070	
宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	10,327,620	10,327,620			
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司—上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.29%	10,327,620	10,327,620			
韩笑	境内自然人	3.20%	10,052,185	10,052,185	质押	5,415,241	
朱红军	境内自然人	2.24%	7,037,864	7,037,864	质押	3,610,160	
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	5,957,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长川投资系赵轶之配偶、实际控制人之一徐昕控制的合伙企业。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入3,9883.41万元，较上年同比增长84.54%；实现净利润1,193.53万元，较上年同比下降67.27%；全年经营现金净流量为-4,288.98万元，较上年同比减少444.51%。

报告期内，公司各项重点工作完成如下：

1、报告期内，公司完成重大资产重组，通过发行股份的方式购买国家产业基金、天堂硅谷和慧、装备材料基金持有的长新投资90%的股权。本次交易完成后，本公司将持有长新投资100%的股权，长新投资持有新加坡STI 100%的股权。STI是研发和生产为芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商

截止2019年12月31日，STI拥有178项专利技术，主要产品有转塔式测编一体机、平移式测编一体机、膜框架测编一体机和晶圆光学检测机。其中转塔式测编一体机主要用于传统的封装终检市场，有引脚的芯片及无引线封装市场。平移式测编一体机主要用于BGA、QFN和有引线封装等先进封装市场。膜框架测编一体机主要用于晶圆级封装终检市场。晶圆光学检测机主要用于晶圆制造及封装过程中的检查市场。STI历来重视产品质量，建立了涵盖研发、供应链、生产、销售全过程的多层次、全方位质量管理体系，保证产品的专业化生产和质量的稳定可靠。STI集成电路封装测试设备在核心性能指标上已达到国际领先水平，并且价格较有竞争力，使得STI的产品在市场上具有较强的竞争力。STI产品的下游客户包括德州仪器、美光、意法半导体、三星等大型半导体生产公司及日月光、安靠技术等世界一流的半导体封装和测试外包服务商，具备领先的客户优势。STI等设备制造商与下游客户建立了密切的长期联系，其与下游客户的联系较为稳定，主营业务发展较为稳健。

本次交易完成后，STI的优质资产及业务将进入上市公司，有助于上市公司丰富产品类型，发挥协同效应，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。本次交易中上市公司拟收购的上述资产具有较强的盈利能力，资产质量良好，注入上市公司后将有利于提高上市公司的资产质量，增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。上市公司净资产规模进一步增大，盈利能力进一步增强。因此，本次交易可以提高上市公司资产质量，改善公司财务状况和增强持续盈利能力。

2、公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于测试机、分选机、探针台、自动化设备等专用平台的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能，同时加强研发团队力量，与国内多所知名院校就业办建立了合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司研发费用支出10,697.84万元，占营业收入比例的26.82%，公司产品核心竞争力得到持续提升。公司持续加强知识产权体系管理及无形资产保护，报告期内，公司拥有312项专利权（其中发明专利223项，实用新型89项），47项软件著作权。

3、报告期内，公司对外积极开拓市场，成功开拓了台湾市场和东南亚市场，有序推进了新客户的导入工作，公司客户

结构持续优化；同时，公司为了扩大产品市场份额以及产品的应用领域，拓展台湾市场，使公司在行业内的影响力得到进一步提升。

4、报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，制定和修订了《公司章程》、《媒体采访接待管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度，上述制度的制定或修订，进一步完善了公司治理结构，对公司的长远发展有着重要的意义。

5、人才是企业发展的根本动力，公司高度重视人才的力量，大力实施人才战略。报告期内，公司开展新员工入职培训工作和导师培训工作，继续深化了与外部培训机构的合作，通过系统的培训，管理者的管理理念明显提升，管理技能得到加强。公司校招及社招一直有序进行，并从一批985、211高校中挑选了大批优秀毕业生，为公司未来的可持续发展提供了人才保障，并开始实施部门和个人考核，逐步导入考评机制。

6、报告期内，鉴于供公司当前情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，审议通过《2018年度利润分配预案》的议案。2018年度的利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本149,108,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利为人民币14,910,840.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每10股转增9股，转增后公司总股本增加至283,305,960股。

本次权益分派股东大会审议通过至实施前，公司总股本因2017年度首次授予限制性股票股份回购注销发生变化，回购注销股本数为14,022股，公司总股本数由149,108,400股变更为149,094,378股，具体详见交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网2019年5月28日公告《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-055），截至目前，公司回购专用账户股份数为0股。根据公司2018年度利润分配预案，权益分派派发现金股利为人民币14,910,840.00元（含税），转增股本总数为134,197,560股。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司本次权益分派分配比例应当按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则进行调整。因此，按公司当前总股本折算每10股派发金额=本次权益分派现金分红总额/公司当前总股本*10股=14,910,840.00/149,094,378*10=1.000094元（含税）。按公司当前总股本折算每10股转增股本=本次权益分派转增总额/公司当前总股本*10股=134,197,560/149,094,378*10=9.000846股，转增后公司总股本增加至283,291,931股。并于2019年6月14日实施完毕。

7、报告期内，随着公司规模不断扩大，为满足市场开拓和战略发展的需要，公司以自有资金1500万元收购法特迪精密科技（苏州）有限公司总股本的10%。法特迪精密科技（苏州）有限公司成立于2014年，所处的行业为集成电路材料业，其产品为细分市场芯片测试领域中的耗材-芯片测试接口。目前，法特迪已与国内外众多知名芯片厂商、封测商及设备商形成良好的合作关系，稳定供货；已经合作的客户累计超过150家，客户包括NVIDIA英伟达、Sierra Wireless、矽品科技、博世、瑞芯微电子、星科金朋、展讯通信等芯片设备制造商、封装测试厂和测试设备企业等。

8、报告期内，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成。公司2017年限制性股票激励计划首次授予的对象为57人，本次可解除限售的激励对象人数为56人，可解除限售的限制性股票数量为103.0218万股。股权激励成功解锁使员工转变为企业主人翁，将自身利益与股东利益紧密结合，积极主动地参与企业决策、承担风险，并分享企业成长带来的效益，员工能积极主动地关心企业的长期健康发展与价值增长，从而促进企业一步步健康发展、团结稳定。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路电子工业专用设备	398,834,098.54	3,934,411.87	51.15%	84.54%	-88.51%	-4.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内收购STI股权，合并报表范围发生变更

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	166,917,086.23	应收票据	50,807,907.39
		应收账款	116,109,178.84
应付票据及应付账款	124,422,691.10	应付票据	59,270,571.25
		应付账款	65,152,119.85

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	50,807,907.39	-50,807,907.39	
应收款项融资		50,807,907.39	50,807,907.39

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	179,922,853.62	以摊余成本计量的金融资产	179,922,853.62
应收票据	贷款和应收款项	50,807,907.39	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	50,807,907.39
应收账款	贷款和应收款项	116,109,178.84	以摊余成本计量的金融资产	116,109,178.84
其他应收款	贷款和应收款项	1,703,039.11	以摊余成本计量的金融资产	1,703,039.11
短期借款	金融负债	20,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	20,000,000.00

应付票据	其他金融负债	59,270,571.25	以摊余成本计量的金融负债	59,270,571.25
应付账款	其他金融负债	65,152,119.85	以摊余成本计量的金融负债	65,152,119.85
其他应付款	其他金融负债	56,839,088.82	以摊余成本计量的金融负债	56,839,088.82

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	179,922,853.62			179,922,853.62
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22	50,807,907.39			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-50,807,907.39		
按新CAS22列示的余额				
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	116,109,178.84			116,109,178.84
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,703,039.11			1,703,039.11
以摊余成本计量的总金融资产	348,542,978.96	-50,807,907.39		297,735,071.57
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：自应收票据(原CAS22)转入		50,807,907.39		
按新CAS22列示的余额				50,807,907.39
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		50,807,907.39		50,807,907.39
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				

按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	20,000,000.00			20,000,000.00
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	59,270,571.25			59,270,571.25
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	65,152,119.85			65,152,119.85
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	56,839,088.82			56,839,088.82
以摊余成本计量的总金融负债	201,261,779.92			201,261,779.92

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	8,754,630.57			8,754,630.57
其他应收款	256,069.20			256,069.20

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
长新投资公司	2019年7月26日	540,458,673.80	100.00	增资/股权转让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
长新投资公司	2019年7月26日	完成变更登记	132,481,827.90	6,946,457.02

(2)其他说明

2018年5月28日，公司与宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司（以下简称天堂硅谷投资公司）签订股权转让协议，无对价受让天堂硅谷投资公司对长新投资公司的500万出资义务，同时公司对长新投资增资4,500万，取得长新投资10%股权，并

于2018年8月22日支付了上述款项。2018年5月30日，长新投资公司完成本次工商变更登记手续。

2019年1月18日，公司召开股东大会审议通过以发行股份的方式购买国家产业基金、天堂硅谷以及上海装备合计持有的长新投资公司90%股份，上述股权转让的定价系以坤元出具的坤元评报〔2018〕598号《资产评估报告》，以2018年9月30日为评估基准日采用收益法确定的股东全部权益评估值为54,480.27万元，经交易双方协商确定交易价格为49,032.26万元，调整公司2018年度权益分派实施的影响，最终交易价格确定为49,045.87万元。2019年7月26日，长新投资公司完成本次工商变更登记手续，并成为本公司全资子公司。